《固化型银导体浆料》行业标准修订

编制说明

1. **工作简况**
2. **任务来源**

**1.1计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员（单位）**

2018年10月，贵研铂业股份有限公司提出修订本行业标准的建议书。于2019年4月由工业和信息化部下达该标准的修订任务，计划批准文件名称：《固化型银导体浆料》，计划文工信厅科函[2021]234号，计划号：2021-0877T-YS。项目名称：固化型银导体浆料。项目周期18个月。

编制组成员：贵研铂业股份有限公司、贵研电子材料（云南）有限公司、云南贵金属实验室有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

**1.2项目编制组单位变化情况**

修订过程中项目编制组单位增加了贵研电子材料（云南）有限公司、云南贵金属实验室有限公司、有研亿金新材料有限公司，由贵研铂业股份有限公司、贵研电子材料（云南）有限公司、云南贵金属实验室有限公司、有研亿金新材料有限公司共同编制。

1. **主要参加单位和工作成员及其所作的工作**

**2. 1主要参加单位情况**

贵研铂业股份有限公司（简称：贵研铂业，证券代码：600459）于2000年由中国唯一从事贵金属多学科领域综合性研究开发机构昆明贵金属研究所（简称：贵研所）发起设立，是集贵金属系列功能材料研究、开发和生产经营于一体的高新技术企业，于2003年在上海证券交易所上市。贵研铂业专注于贵金属新材料制造、资源再生、商务贸易，立足于做强产品，做大贸易，拓展资源。产品包括贵金属特种功能材料、环保及催化功能材料、信息功能材料、再生资源材料等五大类,共计390多个品种、4000多种规格，产品主要用于航空、航天、航海、国防军工、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保能源、钢铁等行业。

公司以标准引领行业发展，持续保持贵金属领域标准制（修）订的优势地位。截止2022年底，贵研铂业主持制修订制修订国家军用标准41、国家标准84项、行业标准147、团体标准5项，合计277项。

此外，公司实施人力资源开发战略，着力打造高知识、高技能、高素质的技术开发队伍、营销商务队伍、职能管理队伍和产业工人队伍。公司员工中，技术人员占31%、本科及以上学历占62%。公司已搭建了包含贵金属冶金、材料、化学化工、工业催化、加工、检测、信息、商务等专业人才梯队；储备了一批以海外留学博士领衔的年轻专业技术人才团队，为贵金属产业可持续发展提供人才支撑。贵研铂业可提供从贵金属原料采-供-销、产品加工到废料回收利用的一站式综合服务，在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系，集产学研为一体，使公司在行业竞争中占据了明显的综合竞争优势。

云南贵金属实验室由贵研铂业股份有限公司出资3000万元注册设立，注册名称：“云南贵金属实验室有限公司”，组织形式为有限责任公司，是集政、产、学、研、用、金为一体的新型研发机构，注册地为昆明高新技术开发区科技路988号。建设运行由贵研铂业和省财政按不低于3:1比例共同投入，首个建设周期（5年），财政支持5亿元，贵研铂业以资产使用权+现金方式匹配，包括基础研究委托开发、研究材料、研发实验场地、研发实验设施、孵化平台、人才引进培养费，合计15亿元。运行管理采取董事会领导下的实验室主任负责制，实行投资控股权与管理权分离，按董事会授权或章程独立运行；机制采用市场化的人才“引培用”机制、科技项目揭榜制、成果收益共享和跟投机制，激发研发活力与动力；内外并举，引进国内外高层次人才，组建高水平研发队伍。建立以标志性成果应用、产业发展质量和产值增长翻番等为导向的考核评价、激励约束机制。主要服务领域为：新材料技术研发、新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工、有色金属合金制造、有色金属合金销售。

有研亿金主要研发、生产、销售微电子光电子用超高纯金属原材料、薄膜新材料、贵金属电子浆料，是国内材料种类齐全的高端电子信息材料、形状记忆合金材料、稀贵金属功能材料研发制造基地。其中，高端电子信息材料产品涵盖电子信息行业用的全系列高纯金属材料、溅射靶材和蒸发镀膜材料，是国内屈指可数具备从超高纯原材料到溅射靶材、蒸发膜材垂直一体化研发和生产的产业化平台。有研亿金目前拥有国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、北京市企业技术中心、北京市高纯金属溅射靶材工程技术研究中心、中国半导体材料十强企业等荣誉、资质。目前是国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟成员单位、中关村集成电路产业联盟理事单位、中国半导体行业协会半导体支撑业分会、上海黄金交易所综合类会员、国家贵金属学术委员会副主任单位、中国有色金属工业协会铂族金属分会理事单位、中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长单位。目前，公司现有职工400余人，汇聚了稀有和贵金属领域内众多一流的科研生产精英，高学历、高职称人才比例较高，同时拥有一支技术过硬经验丰富的技术工人队伍。

有研亿金历年承担国家级、省部级科技开发项目近百项，其中公司承担了国家02专项、国家国际重点合作项目、国家高技术产业化项目、国家科技支撑项目、863项目等36项国家重点项目，为我国新材料产业的发展起到巨大支撑作用。公司共获国家科技进步奖特等奖子项奖1项、国家科技进步奖3项、国家发明奖9项、全国科学大会奖2项、部级奖56项；共申报专利298项，授权188项，颁布国家/行业标准65项，国际标准2项。有研亿金公司的高纯金属溅射靶材技术开发能力居于国内领先、国际先进水平，产品在国内外市场发展前景广阔。

**2.2主要工作成员所负责的工作情况**

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及其工作职责

|  |  |
| --- | --- |
| 起草人 | 工作职责 |
| 李章炜 | 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调、试验验证 |
| 幸七四、杨博文、 | 标准编写材料的收集、提供理论支持、文献支持、测试参数确定及标准部分内容编写 |
| 张晓杰、李燕华 | 负责提供企业的现场、产品及其及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
| 李俊鹏、罗云、  莫建国、刘继松、朱武勋 | 技术指导及客户调研工作 |
| 何金江、关俊卿、贺昕 | 市场数据的收集整理、试验测试和验证 |

1. **主要工作过程**

**1、项目确定阶段**

贵研铂业股份有限公司接到标准修订任务后，组织人员查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，并征求了使用企业的意见，作为建立本技术标准的技术依据，也考虑了国内厂家生产实际和分析水平等情况，于2019年4月由公司相关技术人员组成了《固化型银导体浆料》标准起草小组，主要进行如下工作：

1）确立《固化型银导体浆料》标准修订遵循的基本原则；

2）对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

3）查阅相关标准；

4）确定产品主要技术内容；

5）确定建立仲裁分析方法；

6）根据测试数据确定技术指标取值范围。

**2、立项阶段**

2018年10月，贵研铂业股份有限公司提出修订版本标准行业标准的建议书。于2019年4月工业和信息化部下达该标准的修订任务，项目起止时间为2021年～2022年，计划文工信厅科函[2021]234号，计划号：2021-0877T-YS，项目周期为18个月。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会。

**3、起草阶段**

**3. 1召开标准进度汇报及进度协调会**

2022年7月，由有色金属技术经济研究院有限责任公司主持，在河南省洛阳市召开了任务落实会，根据任务落实会会议精神、与会专家的意见和国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的有关标准修订计划的要求，标准起草小组于2022年9月形成了标准预审稿《固化型银导体浆料》。

**4、征求意见阶段**

**4. 1标准征求意见会议**

2022年11月1日～11月5日全国有色金属标准化技术委员会在福建省厦门召开了《2022年度全国有色金属标准化技术委员会 及各分技术委员会年会》。会议论证了2023年度有色金属国家标准、行业标准和协会标准制修订计划项目，对多项重金属、贵金属国家、行业和协会标准进行审定、预审、讨论和任务落实。对本标准的相关技术文件进行了分析和讨论，并安排了后续工作。

2023年2月21日～2月23日全国有色金属标准化技术委员会在广东省佛山市召开了《“镍钴锰三元素复合氧化物”等91项有色金属标准工作会》，会议对《固化型银导体浆料》的修订进行了讨论，提出了进一步修订的具体内容。编制小组认真听取了会议的意见和建议，对标准进行进一步修订，包括增加《固化型银导体浆料》中定义部分，对本文件中涉及的粘度、细度、方阻、附着力等术语补充定义；对附录等进行相关修订，使标准内容更规范和全面。

**4.2标准发函征求意见**

2022年9月～11月以会议的形式召开工作会议以及通过网络、微信和电子邮件等方式在全国开展征求意见意见工作，对14家相关研究院所、生产企业、下游用户以及第三方检测机构进行了征求意见，发送《征求意见稿》的单位数14个，收到《征求意见稿》后，回函的单位数14个，回函并有建议或意见的单位数9个。编制组单位根据回函意见，对标准稿进行了修改和完善，并于2022年12月形成了送审稿。

1. **审查阶段**
2. **1标准技术专家审查会议**

**5. 2委员审查会议**

1. **报批阶段**
2. **标准编制原则**

贵研铂业股份有限公司接到制定任务后，认真分析和研究国内外相关标准的基本内容和特点，以YS/T 606-2006为基础，参考国内外相关标准，既考虑标准的先进性，也考虑标准的适用性和可操作性，力求使该标准与国外先进标准接轨。

该标准的制定既能体现生产方的技术水平，又能满足使用方的技术要求。

修订过程严格安装标准制定和修订的标准技术路线开展工作。该标准的修订中主要遵循了统一性、协调性、普适性和实用性原则。具体如下：

a) 本标准按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》、GB/T 20000.1 —2014 《标准化工作指南第1 部分：标准化和相关活动的通用术语》、 GB/T 20001.4 —2015 《标准编写规则第4 部分：试验方法标准》

GB/T 1.1—2020给出的规则进行修订和起草。

b) 标准修订应考虑固化型银导体浆料使用工艺，实际应用的情况。

c) 标准修订应充分考虑国内外现有标准法规的统一和协调。

d）标准修订应充分考虑关于固化型银导体浆料发展前景和进步。

1. **标准主要内容的确定依据及验证情况分析**

本标准修订主要是代替YS/T 606-2006《固化型银导体浆料》，主要修订内容如下：

本标准修订主要是代替YS/T 606-2006《固化型银导体浆料》，修订本标准的原则是以国家标准GB/T 17472-2008《微电子技术用贵金属浆料规范》为基础，力求使本系列浆料指标与国际先进浆料指标接轨，既考虑到本浆料标准的先进性，又注重其适应性和可操作性。

主要修订内容如下：

（1）新增规范性引用文件“GB/T 19445 贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存”(见第2章 规范性引用文件，2006年版的第2章)；

**编制依据：**该规范文件对银导体浆料包装、标志等进行规范，参考引用国标文件，使本文件更规范。

1. 增加了固化型银导体浆料及粘度、细度等性能的术语和定义(见第3章，2006年版的第3章)；

**编制依据：**随着行业快速发展，膜片开关银浆的使用条件不断拓宽，目前有快速固化和低温固化等多个发展方向，在此次标准修订工作中按用途重新划分，并在定义中对其作出规定。增加了细度、方阻、附着力、粘度的定义，使标准内容更规范和全面。

1. 将4.1.2 膜片开关用低温银浆的牌号标记方法修改为4.1.2 银浆的标记方法，删除4.1.3 碳膜电位器用银浆的牌号标记方法，删除4.1.4 银导电胶的牌号标记方法(见4.1.2，2006年版的4.1.2)；

**编制依据：**随着技术发展，目前有多种银浆使用范围变宽，原有的标记方法中的后缀已不适用，所以将原标准的标记方法进行修改，提高适用性及先进性。

1. 删除原标准“4.2银浆的组成”（见2006版的4.1）；

**编制依据：**此处银浆的组成与3.1固化型银导体浆料重复。

1. 删除2006年版的4.4.1银浆的细度、粘度性能表2中的产品牌号、不挥发物含量，将微电子封装用银导电胶分为单组分银导电胶和双组分银导电胶，删除原银导电胶细度和粘度要求，新增单组分银导电胶的细度为＜15μm，新增双组分银导电胶的细度为＜10μm。将膜片开关用低温银浆的粘度修改为100-300 dPa·s，将碳膜电位器用银浆的粘度修改为50-300 dPa·s，新增单组分银导电胶的粘度为200-500 dPa·s，新增双组分银导电胶的粘度为250-500 dPa·s。修改后5.1.1性能表1如下(见5.1.1表1，2006年版的4.1.1表2)；

表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品标记 | 细度  m | 粘度  dPa·s |
| PC-Ag-YS/T 606-M | <10 | 100～300 |
| PC-Ag-YS/T 606-MK | <10 | 100～300 |
| PC-Ag-YS/T 606-T | <30 | 50～300 |
| PC-Ag-YS/T 606-AS | <15 | 200～500 |
| PC-Ag-YS/T 606-AD | <20 | 250～500 |

**编制依据：**目前固化型银导体浆料不再将不挥发物含量列入性能指标，所以删除。随着固化型银导体浆料使用领域的不断发展，现在银浆的粘度、细度性能有较大变化。粘度从喷涂所需的低粘度到精密印刷所需的高粘度，范围不断扩大，所以将膜片开关用低温银浆的粘度修改为100-300dPa·s，将碳膜电位器用银浆的粘度修改为50-300dPa·s，微电子封装用银导电胶单组分和双组分之间使用工艺差别较大，原标准中没有进行区分，所以新增单组分银导电胶的粘度为200-500dPa·s，新增双组分银导电胶的粘度为250-500dPa·s。

1. 删除2006年版的4.4.2银浆固化后的主要性能表3中的产品牌号、机械耐久性，将膜片开关用低温银浆的方阻修改为≤40m/□。将原表主要性能电阻率修改为体积电阻率。删除原银导电胶的电阻率，新增单组分银导电胶的体积电阻率为≤1×10-4 ·cm，新增双组分银导电胶的体积电阻率为≤1×10-3 ·cm。将膜片开关用低温银浆的硬度修改为≥2H，新增单组分银导电胶的硬度为≥4H，新增双组分银导电胶的硬度为≥4H。将膜片开关用低温银浆的抗挠折性修改为△R1≤300%。修改后5.1.2性能表2如下：(见5.1.2表2，2006年版的4.4.2表3)；

表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品标记 | 方 阻  m/□ | 体积电阻率  ·cm | 附着力 | 硬度 | 抗挠折性 |
| PC-Ag-YS/T 606-M | ≤40 | —— | 不脱膜 | ≥2H | △R1≤300% |
| PC-Ag-YS/T 606-MK | ≤40 | —— | 不脱膜 | ≥2H | △R1≤300% |
| PC-Ag-YS/T 606-T | <200 | —— | 不脱膜 | —— | —— |
| PC-Ag-YS/T 606-AS | —— | ≤1×10-4 | 不脱膜 | ≥4H | —— |
| PC-Ag-YS/T 606-AD | —— | ≤1×10-3 | 不脱膜 | ≥4H | —— |

**编制依据：**经过调研，目前膜片开关银浆的方阻在40m/□以内，所以将原标准中的膜片开关银浆的方阻范围进行修改。目前无卤的膜片开关银浆由于树脂变化，硬度随之降低，所以无卤膜片开关银浆的硬度要求随之下降至≥2H，故将膜片开关用低温银浆的硬度改为≥2H，新增单组分银导电胶的硬度为≥4H，新增双组分银导电胶的硬度为≥4H。抗挠折性现在测试方法有所改变，所以修改膜片开关用低温银浆的抗挠折性为△R1≤300%。

（7）修改第6章试验方法，银浆粘度的测定按GB/T 17473.5的规定进行。粘度测试条件为剪切速率10s-1，温度25±0.5℃。银浆的固化条件参照附录A。（见第6章，2006版的第5章)；

**编制依据：**由于标准不能规定设备仪器型号，故规定银浆粘度的测定按GB/T 17473.5的规定进行且检测条件为剪切速率10s-1，温度25±0.5℃，根据各单位使用需求自行换算。银浆的固化条件非技术要求，应在试验方法中体现，具体固化条件要求在附录A中详细说明。

（8）修改原标准7.1.1为银浆应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。双方应在订货合同中规定产品技术性能指标波动范围，常见易波动性能为粘度、方阻等，参考数值如下：

a) 粘度范围波动应不大于±10%；

b) 方阻波动应不大于±1 mΩ/□；

**编制依据：**本文件表1、表2中性能参数范围略大，在实际产品中约束力不强，应在订货合同中详细约束，保证产品质量及本文件的适用性。

（9）修改7.3检验项目为每批银浆应进行细度、粘度、方阻、体积电阻率、附着力、硬度、抗挠折性及外观的检验。其他检验要求应在订货合同中注明。检验项目及取样要求按照表3要求确定。需方提出的其它检验项目，由供需双方协商确定。

表3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 取样方法 | 要求的章条号 | 检验或试验方法的章条号 |
| 细度 | 随机抽取一瓶，搅拌均匀，取样2g-20g | 5.1.1 | 6.1 |
| 粘度 | 5.1.1 | 6.2 |
| 方阻 | 5.1.2 | 6.3 |
| 附着力 | 5.1.2 | 6.4 |
| 硬度 | 5.1.2 | 6.5 |
| 体积电阻率 | 5.1.2 | 6.7 |
| 抗挠折力 | 5.1.2 | 6.8 |
| 外观质量 | 逐瓶 | 5.2 | 6.9 |

**编制依据：**增加检验项目及取样要求表方便查询检验及取样标准，将通用指标进行检测规定，非通用指标协商规定。

（10）修改原标准“7.2包装、运输、贮存”（见8.2，2006年版的7.2）

将原标准修改为8.2 包装、运输和贮存

8.2.1 包装瓶应耐浆料腐蚀，不易破损。瓶口应用胶带缠绕密封，然后装入包装箱中，包装瓶四周应充填安全物质。外包装参照GB/T 19445的规定进行。

8.2.2 运输应防污染、防火、防潮、防热。有特殊需求时，在订货合同中注明。

8.2.3 浆料一般应在5～25 ℃下贮存，保质期限为3-6个月，对于特殊要求浆料的运输及贮存条件需双方协商，并在订货合同中注明。

**编制依据：**原标准包装要求未参照国标进行规定，现参考GB/T 17472—2008、GB/T19445进行修改，其他修改规定依据来自市场调研。

如下为新旧标准水平对比表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 老标准 | 修订标准 | 标准水平 |
| 产品分类 | 考虑不全，分类不涵盖现有的产品 | 以银浆用途为划分，将新老产品全部包含在内 | 先进 |
| 产品性能指标 | 范围窄，缺乏实际应用意义 | 考虑全面，涵盖所有固化型银导体浆料 | 先进 |

根据工作计划，贵研铂业股份有限公司公司于2019年4月组织相关技术人员组成了《固化型银导体浆料》标准制定起草小组，主要进行如下工作：标准起草成员深入生产现场调研生产工艺、设备、检验工艺过程，了解产品性能，建立本标准的技术依据。同时组织人员查阅和检索国内外有关该产品技术标准和资料，开展对用户的调研工作，确定了不同厂家对使用工艺的要求及性能应用的范围，相关技术指标如下表：

不同使用厂家技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指  标  项  目 | 技术指标 | | | | | | | | | | | |
| 膜片开关用低温银浆 | | | 碳膜电位器用银浆 | | | 单组分银导电胶 | | | 双组分银导电胶 | | |
| A用户 | B用户 | C用户 | A用户 | B用户 | C用户 | A用户 | B用户 | C用户 | A用户 | B用户 | C用户 |
| 固化温度  (℃） | 80 | 160 | 130 | 180 | 200 | 210 | 120 | 150 | 200 | 80 | 150 | 25±5 |
| 固化时间  (min) | 90 | 30 | 2 | 25 | 25 | 30 | 15 | 30 | 60 | 30 | 90 | 720-1440 |
| 细度  (μm) | <10 | <10 | <10 | <30 | <30 | <30 | <15 | <15 | <15 | <20 | <20 | <20 |
| 粘度  (dPa·S)  剪切速率10-1 | 180～200 | 250～300 | 100～200 | 160～200 | 50～100 | 200～300 | 200～300 | 250～300 | 400～500 | 250～300 | 450～500 | 300～350 |
| 方阻  (mΩ/🞎) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | <200 | <200 | <200 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| 体积电阻率  (Ω·cm) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | ≤1×10-4 | ≤1×10-4 | ≤1×10-4 | ≤1×10-3 | ≤1×10-3 | ≤1×10-3 |
| 附着力 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 | 不脱膜 |
| 硬度 | ≥2H | ≥2H | ≥2H | —— | —— | —— | ≥4H | ≥4H | ≥4H | ≥4H | ≥4H | ≥4H |
| 抗挠折性 | △R1≤300% | △R2≤300% | △R3≤300% | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |

1. **标准中涉及专利的情况**

本标准的主要技术内容不涉及专利。

1. **预期达到的社会效益等情况**
2. 项目的必要性简述

修订本标准的原则是以中华人民共和国有色金属行业标准YS/T 606-2006为基础。随着电子浆料技术的飞速发展，浆料指标的不断优化，行业标准的不断修订，本标准已远远落后于大部分的企业标准，所以有必要对原标准进行系列修订。

1. 项目的可行性简述

贵研铂业股份有限公司在该领域内是领先的产品供应商，标准起草人员多次参与整个生产和使用流程，且贵研铂业股份有限公司在国内贵金属及有色金属分析领域具有权威地位，其标准起草团队多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，能够胜任标准的编制工作。所以，对于标准的修订在研发和应用方面都十分必要，同时该标准中的修订内容，也进行了试验验证和比较，修改内容切实可行。

1. 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

近年来随着电子信息技术的快速发展，高集成化、轻量化、智能化、绿色化已然成为国内外电子产品的发展方向，因而对作为核心材料的电子浆料需求增大，性能要求提高，应用范围更加广泛。固化型银导体浆料现已成为国民经济发展和现代国防建设不可或缺的重要产品，也是制造各类电子元器件的关键基础材料，广泛应用于国防军工研发、民用家电制造、农业机械生产、工业自动化升级、5G信息技术产业、汽车产业等领域。

在电子信息产业快速发展的过程中，固化型银导体浆料作为其基础材料扮演着重要的角色，研发新型高性能、低成本电子浆料已成为当今社会发展的必然趋势。近年来，由于电子浆料使用要求和技术创新水平的提高，固化型银导体浆料的品种急速增多，规模增大，应用领域更广，因此，不同浆料性能差异逐渐增大，尤其固化型银导体浆料的固含量和粘度性能差异较为明显。现行标准在当前环境下应用范围较窄，固化型银导体浆料分类不明确，部分性能指标不具代表性，未完全涵盖当前应用领域下的新型固化型银导体浆料，无法有效提供规范性指导意义，因此需要在现有行业标准的基础上对相关内容进行修订和完善，以便为固化型银导体浆料行业产品的生产和应用提供更加科学、规范和有效的指导。

本标准的修订是充分考虑了当前市场不同产品现状和应用领域的实际需要，从而对原标准中不完善及不明确的内容做出慎重修订，修订后的标准符合当前市场发展的要求和应用方向，具有可操作性和普遍适用性。

通过本标准的重新修订，可以完善现阶段固化型银导体浆料的分类、应用领域和性能指标等信息，使行业标准更加符合现阶段固化型银导体浆料的发展需要，并对产品生产、应用和交付提供切实可行的指导意义，从而更好的促进该行业的发展。

1. **采用国际标准和国外先进标准的情况**

贵研铂业股份有限公司接到制定任务后，认真分析和研究国内外相关标准的基本内容和特点，以YS/T606-2006《固化型银导体浆料》为基础，参考国内外相关标准，既考虑标准的先进性，也考虑标准的适用性和可操作性，并根据我国原材料加工能力、分析水平等实际情况，力求使该标准与国外先进标准接轨。

该标准的制定既能体现生产方的技术水平，又能满足使用方的技术要求。

本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》的《国家标准规范编写示例》进行编写，以范围—规范性引用文件—要求等内容的顺序编写，内容规范。

YS/T 606-2006《固化型银导体浆料》从发布至今已有十多年，在这期间为规范整个行业起到了巨大的作用，带来了非常大的经济效益。结合生产实践，拟订具有实用性、可操作性，能够满足生产和使用需要的固化型银导体浆料具体技术指标。

1. **与现有相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况**

本标准属于其它有色金属标准体系“贵金属”类。本标准修订时，考虑到与国际标准和规范接轨，在规范性引用文件上按我国标准体系作了调整和编辑， 新修订的《固化型银导体浆料》在安全性方面直接引用和贯彻执行了国家强制性标准，从技术上保证了方法使用的安全和可靠性，条文精炼表达清楚，技术要求全面、准确、科学、合理，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范，可取代原标准。

1. **重大分歧意见的处理经过和依据**

该标准编制过程中，无重大分歧意见。

1. **标志性质的建议说明**

根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性国家行业标准。

1. **贯彻标准的要求和措施建议**

建议本标准批准发布6个月后实施。

1. **废止现行相关标准的建议**

本标准发布实施之日，代替YS/T606-2006《固化型银导体浆料》。

1. **其它应予说明的事项**

标准在申报、立项和起草过程中，得到了全国有色金属标准化技术委员会和其他相关单位的支持、指导和帮助，在此特表示真诚的感谢！标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还存有许多缺憾。请与会专家代表多多赐教，好的经验、办法、建议我们一定采纳学习，以便使本标准更加完善。

贵研铂业股份有限公司

《固化型银导体浆料》行业标准起草小组

2023年3月